

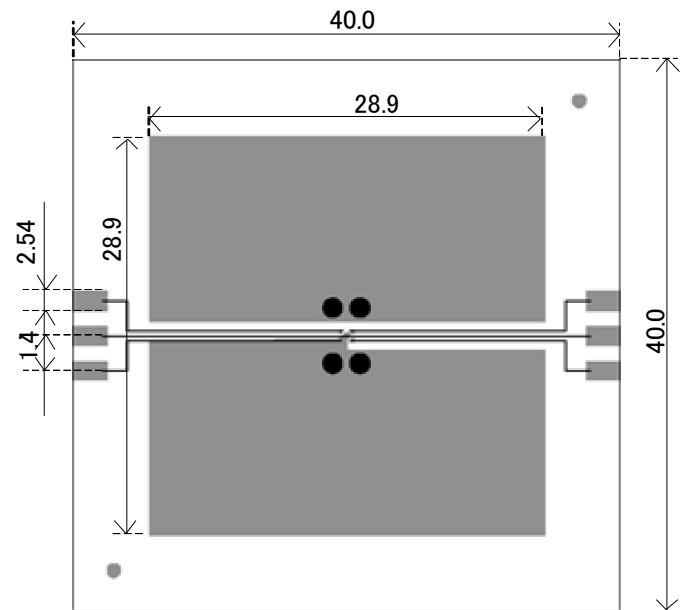
●USPQ-4B05 許容損失

USPQ-4B05 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

- 測定条件: 基板実装状態
- 雰囲気: 自然対流
- 実装: Pb フリーはんだ
- 実装基板: 銅箔 4 層基板 40mm × 40mm (片面 1600mm²)
に対して銅箔面積
- 表面: 全体約 50%_放熱板、リード 1 と接続
- 内層 1 層目: 約 50%_放熱板、リード 1 と接続
- 内層 2 層目: 約 50%_放熱板、リード 1 と接続
- 裏面: 約 50%_放熱板、リード 1 と接続
- 基板材質: ガラスエポキシ (FR-4)
- 板厚: 1.6mm
- スルーホール: ホール径 0.8mm 4 個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

周囲温度 (°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	550	181.82
85	220	

